


 行业动态
Industry News

德州仪器启用位于美国全球最先进的晶圆制造厂

2009-11-05 | 编辑: | [【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【打印】](#) [【关闭】](#)

德州仪器 (TI) 宣布启用位于美国德克萨斯州 Richardson 的晶圆制造厂, 并预计于十月份将设备迁入厂内。该晶圆厂是经过美国绿色建筑协会 (USGBC) 认证的环保工厂, 预计每年的模拟芯片出货总值将超过 10 亿美元。TI 此举将提供数百个工作机会, 同时带动地方教育。

该晶圆厂简称 RFAB (R 表示所在地 Richardson, FAB 表示制造), 是全球唯一使用 300 mm (12 英寸) 硅晶圆制造模拟芯片的生产厂, 而模拟芯片已成为所有电子产品的重要组件。该生产厂将为 TI 提供在批量生产方面的战略性优势, 因为每一片晶圆都能切割出数千个模拟芯片, 数量是一般 200 mm 晶圆可切割数量的两倍更多。

TI 总裁兼首席执行官 Rich Templeton 表示, 目前正是投资的好时机。客户对模拟芯片的需求不断增加, 而且节能环保意识也日趋增强。在该厂生产的芯片将有助于客户生产成千上万种更节能的电子产品, 更有意义的是这些器件是从业界最重视环保的晶圆厂产出。

该晶圆厂使用 TI 的专利生产工艺生产模拟集成电路。客户可以将这些芯片广泛应用在包括智能型手机、上网本乃至电信与计算系统在内的诸多电子产品中。Templeton 指出, 该晶圆厂预计在 2010 年底开始生产芯片。在完成第一阶段的设备安装及量产后, 该厂每年的模拟芯片出货总值将超过 10 亿美元。

RFAB 可立即提供 250 个职位空缺。Templeton 表示, 这些都是优质高薪的工程、制造及行政职位。同时该厂的基础组织架构也将为供货商及支持服务等创造更多间接就业机会。

绿色典范

RFAB 晶圆厂已成为绿色建设的重要典范, 这是第一家获得美国绿色建筑协会 (USGBC) 能源与环境设计先锋 (LEED) 金级认证的半导体工厂。TI 已将从 RFAB 设计所获得的知识运用于全球各地的其它工厂。

近期扩张计划

RFAB 晶圆厂的启用是 TI 一系列扩张生产计划的最新举措。2009 年初 TI 启用位于菲律宾的封装测试厂 Clark。另外, TI 也陆续在许多地点安装全新的测试设备, 目前正计划在全球各工厂安装新购买的 200 mm 制造设备来生产模拟芯片。

TI 对当地教育的贡献

- ▣ [科普首页](#)
- ▣ [微电子历史](#)
- ▣ [行业动态](#)
- ▣ [术语解释](#)
- ▣ [无微不至](#)
- ▣ [芯片制程](#)
- ▣ [科普创意](#)



TI 在 Richardson 设厂的决定有助于当地教育发展。根据当地社区与州合作单位的原始协议，邻近的德克萨斯州大学达拉斯分校总计将收到 3 亿美元捐款。这笔款项来自德克萨斯州企业基金 (Texas Enterprise Fund)、德克萨斯州土地办公室 (Texas General Land Office)、德克萨斯州大学系统 (UT System) 以及资助工程研究计划的个人捐款。

(来源：半导体国际 2009年10月13日)



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号